

MEIKO  
REPORT第49期  
株主通信

(2023年4月1日から2024年3月31日)

証券コード：6787

株式会社 メイコー

## 財務ハイライト

売上高

179,458 百万円

営業利益

11,660 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

11,310 百万円

## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2023年3月31日現在	当期末 2024年3月31日現在
資産の部		
流動資産	91,905	102,839
固定資産	110,489	127,120
有形固定資産	95,537	112,065
無形固定資産	6,999	6,418
投資その他の資産	7,951	8,636
資産合計	202,394	229,960
負債の部		
流動負債	73,672	81,714
固定負債	44,246	42,786
負債合計	117,919	124,501
純資産の部		
株主資本	59,981	69,566
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	13,700	14,242
利益剰余金	35,568	45,146
自己株式	△2,176	△2,710
その他の包括利益累計額	17,339	28,617
その他有価証券評価差額金	13	94
繰延ヘッジ損益	54	45
為替換算調整勘定	17,425	28,467
退職給付に係る調整累計額	△154	10
純資産合計	84,475	105,458
負債純資産合計	202,394	229,960

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2022年4月1日～ 2023年3月31日	当期(累計) 2023年4月1日～ 2024年3月31日
売上高	167,276	179,458
売上原価	141,260	148,910
売上総利益	26,015	30,548
販売費及び一般管理費	16,440	18,887
営業利益	9,575	11,660
営業外収益	3,268	3,917
営業外費用	1,631	1,310
経常利益	11,212	14,267
特別利益	42	542
特別損失	583	936
税金等調整前当期純利益	10,672	13,873
法人税等	1,887	2,458
当期純利益	8,784	11,415
非支配株主に帰属する当期純利益 又は当期純損失(△)	△62	105
親会社株主に帰属する当期純利益	8,847	11,310

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2022年4月1日～ 2023年3月31日	当期(累計) 2023年4月1日～ 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,714	23,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,042	△21,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,961	681
現金及び現金同等物に係る換算差額	250	1,577
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6,884	4,028
現金及び現金同等物の期首残高	10,450	17,334
現金及び現金同等物の期末残高	17,334	21,363

## 財務のポイント

## ●キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、21,363百万円となり、前連結会計年度に比べ4,028百万円増加しました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、23,357百万円で、前連結会計年度に比べ7,642百万円増加しました。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益13,873百万円、減価償却費11,215百万円、仕入債務の増加2,261百万円、減少の主な内訳は、為替差益2,066百万円、法人税等の支払額2,544百万円です。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、21,586百万円で、前連結会計年度に比べ7,456百万円支出が減少しました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出21,447百万円、投資有価証券の取得による支出1,058百万円です。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、681百万円で、前連結会計年度に比べ19,280百万円減少しました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増額1,551百万円、長期借入れによる収入9,100百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出7,991百万円、配当金の支払額1,730百万円です。

## ●連結貸借対照表

総資産は、229,960百万円となり、前連結会計年度末に比べ27,565百万円増加しました。これは流動資産において、現金および預金が4,018百万円増加、売掛金が1,654百万円増加、棚卸資産が2,963百万円増加、流動資産のその他が1,566百万円増加、固定資産において、有形固定資産の16,528百万円増加が主な要因です。

純資産は、105,458百万円となり、前連結会計年度末に比べ20,983百万円増加しました。これは利益剰余金の9,578百万円増加、および為替換算調整勘定の11,041百万円増加が主な要因です。



## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
2024年3月期の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佐一郎**

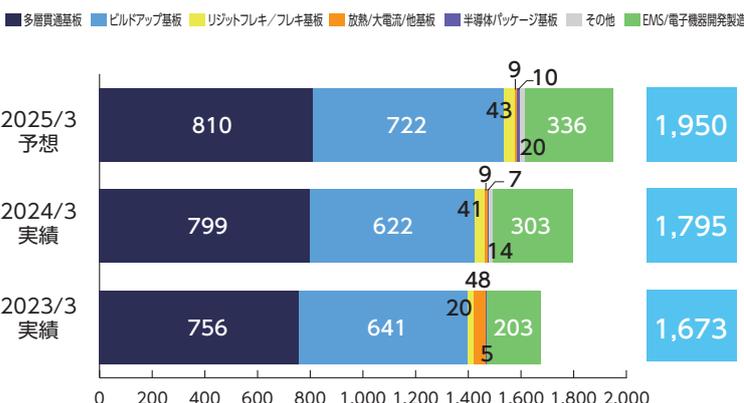
### 連結業績 2024年3月期通期実績 / 2025年3月期通期予想 (単位: 億円)

	2023年3月期 通期実績	2024年3月期 通期実績	増減率	2025年3月期 予想	増減率
売上高	1,673	1,795	7.3%	1,950	8.7%
営業利益	96 5.7%	117 6.5%	21.8%	160 8.2%	37.2%
経常利益	112 6.7%	143 8.0%	27.2%	150 7.7%	5.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	88 5.3%	113 6.3%	27.8%	125 6.4%	10.5%
期中平均為替レート (JPY/USD)	136.0	145.3		145	

### 商品別売上高シェア (単位: 億円)

	2023年3月期実績		2024年3月期実績		2025年3月期予想	
	売上	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	845	60 7.1%	947	81 8.6%	969	95 9.8%
スマートフォン タブレット	271	11 4.1%	266	21 7.9%	238	30 12.6%
半導体パッケージ	5	0 0.0%	7	-15 -214.3%	10	-17 -170.0%
SSD IoTモジュール	100	10 10.0%	85	10 11.8%	77	12 15.6%
衛星通信					80	8 10.0%
AI家電・アミューズメント 産機他商品	249	16 6.4%	187	11 5.9%	240	21 8.8%
EMS 電子機器開発製造	203	-1 -0.5%	303	9 3.0%	336	11 3.3%
合計	1,673	96 5.7%	1,795	117 6.5%	1,950	160 8.2%

### 仕様別売上高シェア (単位: 億円)



## 2024年3月期の実績

当連結会計年度における電子部品業界は、世界的にインフレや金利上昇が進行し、米国を除く主要国の経済や消費が伸び悩む中、地政学的緊張の高まりなどもあり、先行きの不透明感は払拭されるに至りませんでした。一方、半導体不足の解消による自動車生産台数の増加やスマートフォン需要の回復なども見られました。

このような環境の下、当社グループでは、車載向け基板は自動車需要の回復を受け、売上・利益ともに好調に推移しました。スマートフォン向け基板は、中華系スマートフォン向け販売が減少し減収となりましたが、ハイエンドモデル向け基板の拡販に取り組んだ結果増益となりました。EMS事業は受託開発案件が堅調に推移し売上・利益とも大幅に増加いたしました。生産面では受注が拡大したことから工場稼働率が向上するとともに、コスト削減効果、為替の影響等が相まって収益が改善基調となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、179,458百万円(前期比7.3%増)と前期と比べ12,181百万円の増収となりました。損益面では、営業利益が11,660百万円(前期比21.8%増)、経常利益が14,267百万円(前期比27.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益が11,310百万円(前期比27.8%増)となりました。

## 2025年3月期の見通し

当社グループが属する電子部品業界は、自動車に代表される自動運転やこれを支える通信インフラ、AIサーバーの活用をはじめとして様々な分野で高性能な電子部品需要が拡大する見通しとなっております。

次期の当社グループの業績の見通しは、基板事業においては車載向け基板が引き続き全体を牽引する見込みです。取り組みとしては、既存の日系顧客に加え、外資系大口顧客への拡販を進めてまいります。スマートフォン向け基板は、ハイエンドスマートフォン向け基板の拡販に引き続き注力いたします。この他にIoT機器や衛星通信など成長性の高い分野へも注力してまいります。生産面では、半導体パッケージ基板、通信モジュール基板の生産を担う石巻第2工場、ベトナム第3工場の早期収益化に取り組んでまいります。EMS事業は車載向け等の受託開発型商品の拡販に注力してまいります。損益面では引き続き、工場の自動化・省人化、歩留まり改善など生産性の改善を推進しさらなる収益性の強化を図ってまいります。

以上により、業績見通しを売上高1,950億円、営業利益160億円、経常利益150億円、親会社株主に帰属する当期純利益125億円といたしました。

## 今後の方針

### ●資本コストや株価を意識した経営

当社は、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、右図の通り、資本コストや資本収益性を十分に意識した経営に取り組んでおります。

### ●中期経営計画の概要

2023年3月期を初年度とする中期経営計画では、半導体やスマートフォン需要の低迷などの影響を受けておりますが、2027年3月期に売上高2,700億円、営業利益300億円、営業利益率11%の達成に向け順調に推移しております。計画の実現に向けた取り組みを以下にご紹介いたします。

### ●新規事業(半導体パッケージ基板)の状況

半導体パッケージ基板事業は、石巻第2工場でFC-BGA基板、ベトナム第3工場でメモリパッケージ基板の生産を開始いたしました。半導体需要の低迷を受け約1年遅れで進捗しています。

こうした環境下、お客様からの認定の取得、新規案件獲得を積極的に進めており、早期の黒字化を図ってまいります。

### ●新工場の建設

アセアン地域でのサプライチェーンの構築がグローバルで急速に進行しております。当社においても既存工場のキャパシティを超過する引き合いをいただいております。ベトナムに新工場を建設することといたしました。1つめは、ベトナム工場内に既存の第2工場を補完すること、高多層・高密度ビルドアップ基板およびメモリモジュール基板の生産をすることを目的に第4工場を建設します。2つめは、ベトナムホアビン省に中高多層基板や高密度ビルドアップ基板を生産するためホアビン工場を建設することといたしました。



### 資本コストや株価を意識した経営

現状分析	方針	取り組み
◆ROEは 23/3期 10.5% →24/3期 10.7%	◆中期経営計画の 目標達成  ◆財務目標 ROEの向上 自己資本比率の向上 D/Eレシオの良化  ◆企業価値向上に 向けた成長分野 への投資	◆売上・利益の拡大  ◆モノづくり改善 歩留り改善 品質向上 生産性向上  ◆投資戦略 最先端基板に 投資を集中
◆PBRは 23/3期 0.97倍 →24/3期 1.32倍		
◆PERは 23/3期 8.5倍 →24/3期 12.3倍		
◆配当額は 23/3期 55円 →24/3期 68円		
◆時価総額は 23/3期 749億円 →24/3期 1,390億円		

### 中期経営計画 概要



### ベトナム第4工場 事業概要

所在地	ハノイ市タックタット工業団地
延床面積	約60,000㎡ (15,000㎡×4F)
投資規模	約250億円
事業内容	第2工場(PCB)のキャパ補完 高多層・高密度HDI基板 メモリーモジュール基板
稼働時期	2025年度より順次稼働

### ホアビン工場 事業概要

所在地	ホアビン市ダー川左工業団地
敷地面積	約93,000㎡
延床面積	約60,000㎡ (第1工場) (※拡張余地あり)
投資規模	約500億円 (第1工場)
事業内容	中高多層・高密度ビルドアップ基板 (第1工場)
稼働時期	2026年度より稼働予定

### 株主還元について

当社は、株主の皆様に対する利益向上を経営の重点課題の一つとしております。当面は、企業規模拡大のための投資を優先し、売上と利益額の拡大に注力いたします。配当性向の目安を15%とし、利益額の拡大とともに配当額の増加を図ってまいります。

### 配当金

2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期(予想)
55円	68円	72円
第2四半期末 27円 期末 28円	第2四半期末 27円 期末 41円	第2四半期末 36円 期末 36円

株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待にお応えするべく、改善のための各々の施策に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



常務執行役員  
柴田 栄造

本年度は「車載グローバルNO1」を目指し、日欧車載の拡販と、新たに米中韓の大手車載顧客参入に注力、期初は車載半導体の逼迫が長引くとの予想をしていましたが、下期から需要の緩和や代替部品の採用により受注が回復し、スマートフォンのシェアアップの実現などにより、通期売上1,795億円、営業利益117億円を達成しました。

その結果、来年度は車載向け基板の売上1,000億円の達成も現実味をおびてきました。

パッケージ関連事業は数社の顧客承認作業が進み受注も始まる一方、天童新工場は承認基板の作成も開始し、大手車載Tier1メーカーからの量産受注案件も決定しました。また、新たな商品群として衛星通信分野への参入に成功したことは、製販技術一体での活動が実を結んだ大きな成果でした。引き続きBEVや運転支援、次世代車載製品の受注に全力を挙げていきます。

今年は創立50周年を迎える記念の年、メイコーグループの総力を挙げて、2024年度の売上計画1,950億円、営業利益160億円を達成してまいります。

引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

## コーポレートデータ (2024年3月31日現在)

### 会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	11,912名(連結) (国内1,328名・海外10,584名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

### 役員

代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	篠和 政純
取締役専務執行役員	坂田 手純
取締役専務執行役員	枝名 芳
取締役常務執行役員	中屋 允奈洋
取締役常務執行役員	土山 隆文
取締役常務執行役員	原田 俊孝
取締役常務執行役員	小松 弘美
取締役常務執行役員	江尻 琴

※当事業年度末日後に生じた会社における地位及び担当の異動は次のとおりであります。

氏名	変更前	変更後	異動年月日
坂手 敦	取締役専務執行役員 基板事業統括本部長	代表取締役副社長執行役員 基板事業統括本部長	2024年4月1日
名屋 茂	取締役執行役員 株式会社メイコーテック代表取締役 パワーエレクトロニクス本部長	取締役常務執行役員 株式会社メイコーテック代表取締役 パワーエレクトロニクス本部長	2024年4月1日

### 関連会社

株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
メイコーエンベッドプロダクツ株式会社	電子関連事業
メイコーエンベッドテクノロジー株式会社	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
広州市斯皮德貿易有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Towada Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業

※2024年4月1日付で、メイコーエンベッドプロダクツ株式会社はメイコーエレクトロニクス株式会社、メイコーエンベッドテクノロジー株式会社はメイコーエレクトロニクス株式会社、Meiko Towada Vietnam Co., Ltd.はMEIKO ELECTRONICS HAI DUONG VIETNAM CO., LTD.に商号変更しております。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15 ホームページ <https://www.meiko-elec.com/>  
TEL: 0467 (76) 6001 (大代表)

### 見直しに関する注意事項

本報告書に記載されている情報につきましては、当社の計画、業績など将来の見直しに関する記述が含まれており、これらの記述は、その時点で入手可能な情報および当社が合理的であると判断する一定の前提条件に基づいています。実際の業績は、さまざまな要素により、これらと異なる結果となり得ることをご承知おきください。

### 株式情報

発行可能株式総数	普通株式	70,000,000株
	第一回社債型種類株式	100株
発行済株式の総数	普通株式	26,000,803株
	(自己株式 802,517株を除く)	
	第一回社債型種類株式	70株
株主数	普通株式	3,272名
	第一回社債型種類株式	1名

### 大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,704	18.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,774	14.52
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,864	11.02
CLEARSTREAM BANKING S.A.	947	3.64
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC /FIM/ LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	700	2.69
名幸興産株式会社	608	2.34
有限会社ユーホー	521	2.00
株式会社三井住友銀行	377	1.45
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	376	1.45
名屋 精一	355	1.37

※当社は、自己株式802,517株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 所有者別株式分布状況 (普通株式)



### 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 <a href="https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml">https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml</a> ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

### 株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。



この冊子は環境保全のため、植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。